

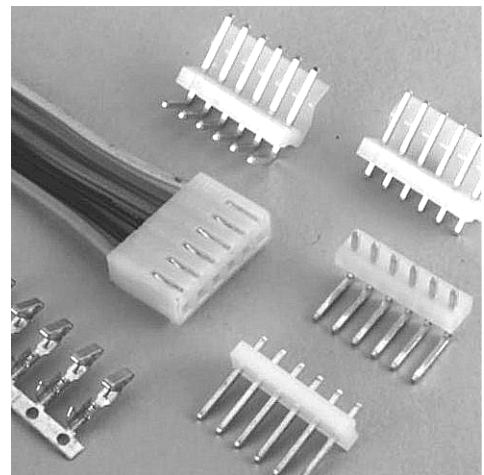
# 533

## Stift- / Buchsenleisten - Crimp-Rast-System - RM 3,96 mm

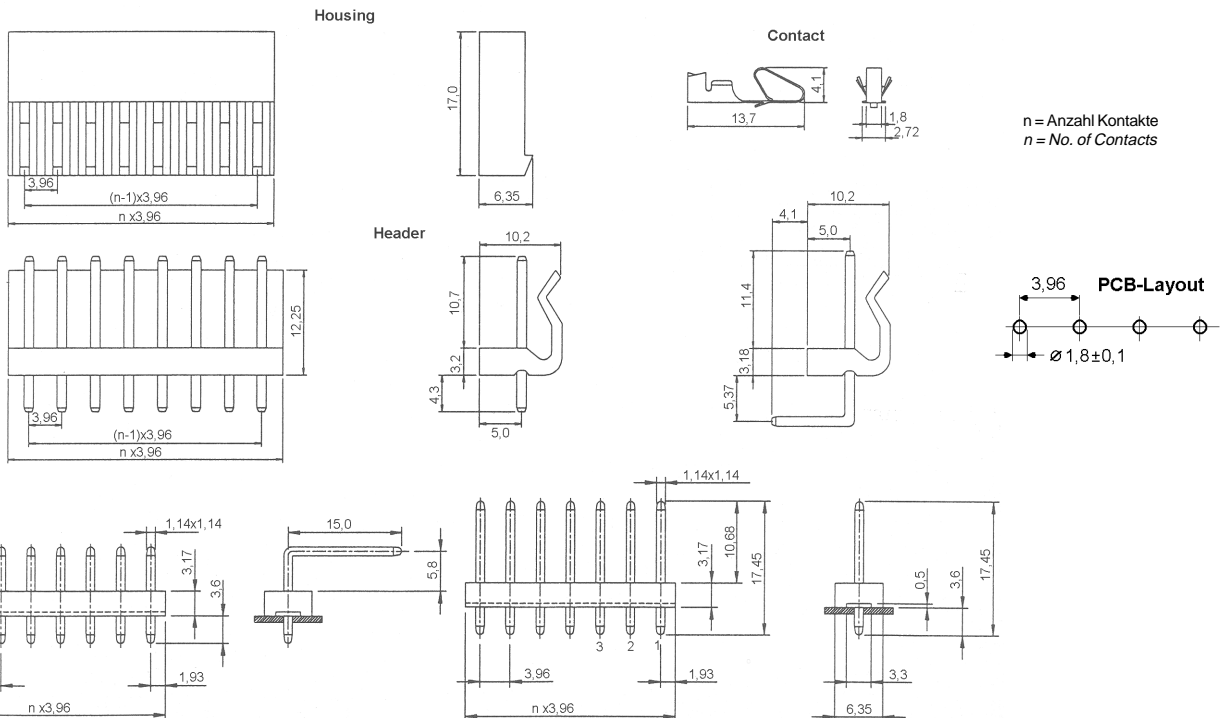
### Friction Lock Header and Crimp-Housing - Pitch 3,96 mm

#### Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94V0
Kontaktmaterial	Messing
Contact Material	Brass
Kabeldurchmesser	AWG 18-24
Applicable wire	AWG 18-24
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Contact Resistance	≤ 20 mOhm
Isolationswiderstand	> 10 <sup>9</sup> Ohm
Insulation Resistance	> 10 <sup>9</sup> Ohm
Spannungsfestigkeit	1500 V <sub>AC</sub>
Test Voltage	1500 V <sub>AC</sub>
Nennspannung	250 V <sub>AC/DC</sub> max.
Current Voltage	250 V <sub>AC/DC</sub> max.
Nennstrom	5 A
Current Rating	5 A
Temperaturbereich	-25°C...+85°C
Temperature Range	-25°C...+85°C
Verarbeitung	Wellen-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Wave-Soldering, further informations in chapter T



© W+P PRODUCTS



K

Series	Contacts*	Type*	Plating*
533	10 02-20-pol.	3 1 = Buchsengehäuse Housing 2 = Buchsenkontakte Crimp-Contacts 3 = Stiftleiste gerade mit Verriegelung Header Straight with Friction Lock 4 = Stiftleiste gewinkelt mit Verriegelung Header Right Angled with Friction Lock 5 = Stiftleiste gerade ohne Verriegelung Header Straight without Friction Lock 6 = Stiftleiste gewinkelt ohne Verriegelung Header Right Angled without Friction Lock	50 50 = verzinkt (Standard) tin plated (Standard) 00 = vergoldet (auf Anfrage) Gold plated (upon Request)  keine Angabe bei Gehäusen Not Necessary for Housings

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* Order example - To be replaced by your specifications.)

## Wellen-Lötverfahren Wave-Soldering

Bauteile sollten bei 260°C für max. 5 Sekunden verarbeitet werden.  
*Items should be soldered at 260°C for max. 5 seconds.*

Empfohlenes Wellen-Lötprofil:  
*Recommended Wave-Soldering profile:*

